

計画名：自動運転社会に向けた半導体界面仕上技術の研究開発

- 認定事業者：東邦エンジニアリング(株)(三重県)
- 共同研究者：国立大学法人大阪大学
- アドバイザー：株式会社デンソー(愛知県)、国立大学法人名古屋大学、国立大学法人名古屋工業大学
- 川下事業者：パワーデバイスメーカー、LEDメーカー、基板材料メーカー
- 事業管理機関：東邦エンジニアリング(株)(三重県)、国立大学法人大阪大学
- 主たる技術：表面処理
- 研究開発概要：

次世代半導体基板は、半導体製造工程においてバルク基板の表面に同種もしくは異種のエピ膜を作り試作されているが、従来技術では目標とする性能が得られていない。これまでバルク基板の平坦化技術として開発してきたCARE法をエピ膜の仕上げに適用することにより、膜厚をナノレベルでそろえる技術を確認し、次世代半導体の性能向上と普及を目指す。

